# 方位角異方性に優れた配向膜の開発(2) Development of advanced alignment materials having excellent azimuthal anisotropy (2)

## <u>富永 哲雄</u>,泉 謙一,高橋 良彰 <u>Tetsuo Tominaga</u>, Ken-ichi Izumi, Yoshiteru Takahashi

## JSR 株式会社 JSR Corporation

方位角異方性に優れた配向膜開発に向けた基礎データを得るためラビング処理したポリイミド 膜について微小角入射 X 線回折測定を行った.製膜方法の異なる脂環式骨格を含むポリイミド薄 膜において、ラビングによるポリイミド薄膜表面の構造変化に違いが現れることが分かった.分 子鎖の屈曲性の違いにより、ラビングによるポリイミド薄膜表面における分子鎖の動きに違いが 現れるためと考えられる.

キーワード: 液晶配向膜,ポリイミド,微小角入射 X 線回折

#### 背景と研究目的:

近年,薄型 TV や公共用表示装置として液晶表示素子の市場が拡大し,表示品位の向上においてもその性能を高める努力がデバイスメーカーで進められている.液晶表示素子の品位向上においては,素子設計を改善するほか,素子を構成する各種部材の性能向上によっても達成される.液晶表示素子に求められる特性は多種に及ぶが,特に昨今バックライト光の強度が強化された影響により従来視認されることのなかった微細な液晶配向不良による光漏れが課題として挙げられている.液晶の配向性は,配向膜と呼ばれる高分子薄膜により制御され,配向膜の配向性改善は,本課題の解決において必要不可欠な対策となる.

配向膜は一般に一軸構造のポリイミド(PI)樹脂から成り,方位角方向(基板面内方向)の配向性 を付与するため、ラビングと呼ばれる表面処理が行われる.ラビング処理により配向膜表面の分 子鎖が延伸されることでラビングの方向に沿った配向性(方位角配向性)が発現する.配向膜の 液晶分子を並べる力(配向規制力)は配向膜を構成するモノマー構造や分子鎖の高次構造によっ て変化することから、それらの配向膜についてラビング後に形成される極表層の構造を調べるこ とにより、方位角異方性に優れた配向膜の開発に結びつく情報を得ることができると考えられる.

ラビング処理により延伸を受ける分子は表面から 10 nm 程度の極表層に限られ, 膜中の大部分 の分子はラビングの影響は受けないことが知られている.このような配向膜極表層の構造解析法 として微小角入射 X 線回折法(GIXD)が挙げられる[1]. ラビング処理したポリイミド薄膜について 実施した前回の GIXD 実験(2009A1968)では,全反射臨界角以上の入射角による膜全体の回折では ラビングによる異方性が検出されなかったのに対し,臨界角以下の入射角による極表面の回折で はラビングによる異方性が検出され,BL19B2 の GIXD 測定はラビングにより形成される極表層 の構造解析に有効であることが分かった[2].今回の実験では,ラビング処理によるポリイミド分 子の配向に関する基礎データを得るため,製膜方法の異なる脂環式骨格を含むポリイミド薄膜 (PI-A および PI-B)について GIXD 測定を行った.

#### 実験:

PI-A は、ポリイミド前駆体について溶液中でイミド化したものを Si 基板上に塗布し、230 ℃ で熱処理することにより作製した. PI-B は、ポリイミド前駆体溶液を通常通りそのまま Si 基板に 塗布し、PI-A と同じ温度で熱処理することにより作製した. ラビング処理は、レーヨン製ラビン グ布を用い回転数 400 rpm、ステージ速度 30 min/sec、押し込み長 0.4 mm で行った.

GIXD 測定は, BL19B2 の多軸回折装置を用いて行った. X線のエネルギーを 10 keV とし,回 折 X線は発散角 0.2°のソーラースリットを通してシンチレーションカウンターで検出した. 試料

は標準のサンプルホルダーに取り付け,バックグラウンド低減のためカプトン製のドーム状カバーで覆い He 雰囲気中で測定を行った. GIXD 測定における入射角を決めるため,事前に X 線反射率測定を行い試料の全反射臨界角を求めた.

## 結果および考察:

Fig.1 に PI-A の X 線反射率プロファイルを 示す. 矢印(a), 矢印(b)で示される PI-A 膜お よび Si 基板の全反射臨界角は, それぞれ, 0.135°, 0.180°となった. 同様の測定によ り PI-B の全反射臨界角も 0.135°となった. 従って,入射角が PI-A の臨界角 0.135°より 大きく Si 基板の臨界角 0.180°より小さい場 合, 回折 X 線は PI 膜全体の情報となり, 0.135°より小さい場合, X 線の侵入深さの 数 nm 程度の極表面の情報となる. そこで, GIXD 測定における入射角は, PI 膜全体の測 定について 0.160°, 表面敏感な測定につい て 0.100°に設定した.

Fig.2 に入射角 0.160°で測定した PI 膜全 体からの GIXD プロファイルを示す.上段が PI-A, 下段が PI-B に対応し,赤丸はラビン グ方向と散乱ベクトルが垂直な試料配置,青





四角は同じく平行な試料配置,緑三角はラビング処理していない試料におけるデータである. PI-A, PI-B とも前回測定した芳香族 PI 膜のような結晶由来の鋭いピークは検出されずアモルファス特 有のハローパターンであることから,いずれもアモルファス構造をとっていることが分かる.平 行配置と垂直配置のプロファイルがほぼ一致することから, PI 膜全体ではラビングによる異方性 は検出されないことが分かる.





Fig.2 Bulk sensitive diffraction (GI angle:  $0.160^{\circ}$ ) from PI films.

Fig.3 Surface sensitive diffraction (GI angle:  $0.100^{\circ}$ ) from PI films.

Fig.3 に入射角 0.100°で測定した PI 膜極表 層からの GIXD プロファイルを示す. PI-A について $q = 11.5 \text{ nm}^{-1}$ のブロードなピークが 水平配置に比べ垂直配置で強いことが分か る.このような異方性は前回測定した結晶性 の芳香族 PI 膜でも検出されており、ラビン グにより配向した結晶における分子鎖間距 離に対応する回折が垂直配置で強くなった と解釈される. PI-A においてもラビングに より延伸された分子鎖がラビング方向に整 列することにより分子鎖間距離に対応する 回折が垂直配置で強くなったと考えられる. Fig.4 に, q=11.5 nm<sup>-1</sup>のピークに対応する回 折角に検出器を固定して試料法線方向を回 転軸に PI-A 膜試料を回転させたロッキング スキャンを示す. 散乱ベクトルとラビング方 向が垂直となる 0°方向の強度が大きいこと



Fig.4 In-plane rocking scan profile of rubbed PI-A film.

から,分子鎖がラビング方向に整列するという描像を裏付けるデータとなっている.一方,PI-B では PI-A のようなラビングによる異方性は検出されなかった.製膜後の熱処理でイミド化した PI-B は溶液中でイミド化した PI-A に比ベイミド化率が低く屈曲性が高いと考えられる.従って, PI-B は PI-A に比べ分子鎖が屈曲していることからラビングにより延伸された場合でも PI-A のよ うに分子鎖が整列しないため GIXD プロファイルの異方性が検出されなかったものと考えられる.

## 今後の課題:

今回の実験から,分子鎖の屈曲性の違いによりラビングによる PI 膜極表面の構造変化に違いが 現れることを示唆するデータが得られた.今後,分子構造の異なる PI 膜について同様の実験を継 続して進め,方位角異方性に優れた配向膜開発に向けた基礎データを得ていく.

## 参考文献:

[1] M. F. Toney, et al., Nature, 347, 709, (1995).

[2] 冨永, 泉, 植阪, SPring-8 重点産業利用成果報告書, 2009A, 233, (2009).